シリコン表面酸化における吸着酸素配向と反応経路の相関

日大生産工(学部)

○岡部 優希 原子力機構 津田 泰孝、吉越 章隆 東北大 高桑 雄二 日大生産工 小川 修一

## 1. まえがき

現在のコンピュータに組み込まれる MOSFETでは、高誘電率ゲート絶縁膜とSi基板 界面に、熱酸化で形成したSiO2膜が必要不可欠 である。特に、近年のMOSFETの極小化に対応 するためにSi初期酸化過程における反応制御 が強く求められている。

これまでSiウェハ初期酸化過程の研究では、 Si(001)表面での酸化過程と、表面が酸化膜で完 全に覆われてから進行する界面酸化を区別し て議論してきた。表面酸化において、酸化膜成 長モデルとしてdual-oxide-species (DOS)モデル が広く用いられてきた<sup>1)</sup>。一方、我々はDOSモ デルに代わるモデルとして、LoopAとLoopBの 2つの反応パスが存在するというモデルを提 案した<sup>2,3)</sup>。

本報告では、Loop A/Bの反応パスにおいて、 酸化温度依存を明らかにするため、リアルタイ ムX線光電子分光(XPS)を利用し酸化速度の 温度依存ならびに表面酸化における酸素吸着 状態を調べた。

2. 実験方法および測定方法

実験は SPring-8 の BL23SU にて行った。試料は n-Si (001) ウェハを用いた。RCA 洗浄した Si ウェハを真空槽内に導入し 10<sup>8</sup> Pa の超高真空中で 900°Cにて 10 分間のアニールを行い、Si(001)2×1 清浄表面を得た。試料温度を 300°Cおよび 550°Cに設定し 5.0×10<sup>6</sup> Pa の乾燥 O<sub>2</sub> ガスで酸化させた。酸化中にエネルギー695 eV の軟 X線でリアルタイム XPS 観察を行った。測定では O1s と Si2p スペクトルを時間分解で測定し、それぞれのスペクトルから酸素吸着量と酸素吸着配向性、ならびに膜厚の時間変化を得た。

## 3. 実験結果および考察

Si 2pスペクトルにおける酸化物成分と非酸化物成分の比から求めた酸化膜厚Xoの時間変化をFig.1に示す。酸化開始前でも膜厚が0にな





っていないが、これは実験開始前までに表面に 吸着してしまった酸素の影響である。Xoの時 間変化に対して、下記の式(1)を用いてフィッ ティング解析を行なった。

 $X_{O}(t) = A_{A} \cdot (1 - \exp(-k_{A} \cdot t))$ +  $A_{B} \cdot (1 - \exp(-k_{B} \cdot t))$  (1) 本式はラングミュア型吸着をベースとし<sup>4)</sup>、 二種類の反応パス (Loop A/B) の存在を仮定し たものである。ここで、 $A_{A} \ge A_{B}$ は飽和膜厚、 $k_{A}$  $\ge k_{B}$ は反応係数であり、 $A_{A} \ge k_{A}$ はLoop Aのパ ラメータ、 $A_{B} \ge k_{B}$ はLoop Bのパラメータであ

Interrelation of Oxygen Adsorption Orientation and Oxidation Reaction Pathway by Si Surface Oxidation

Yuki OKABE, Yasutaka TSUDA, Akitaka YOSHIGOE, Yuji TAKAKUWA and Shuichi OGAWA



Fig.2 Schematic illustration of Loop A/B oxidation model on Si(001) surface.

る。Fig.1に示すように、式(1)はXOの時間変化 を酸化温度に依存せず再現することができて いる。この結果から、各温度においてLoopAと Loop Bの寄与の割合が明らかになった。300℃ ではLoop AとLoop Bの割合が2:1程度であるが 550℃ではその割合が25:1程度となる。すなわ ち、低温酸化ではLoop Bの割合が低くなること がわかった。

Loop AとLoop Bの反応パスの模式図をFig. 2に示す。本モデルは一段階酸化のLoop Aと二 段階酸化のLoop B、二つの酸化メカニズムによ って表面酸化と界面酸化が同時に進行するこ とを考慮したモデルである<sup>2,5)</sup>。Si(001)表面に 吸着した酸素分子は解離してダイマーのバッ クボンドに入り、Si基板に大きなひずみが生じ る。このひずみを緩和するためにSi原子が基板 の格子位置から放出されることで空孔が形成 される。不対電子対をもつ空孔V<sup>0</sup>は、Si基板上 の多数キャリアの捕獲 (*k*Mcr) によって電子対 をもつ化学的に不活性な状態Vとなる。Vに物 理吸着したO<sub>2</sub>分子(O<sub>2</sub>(phys))が寿命経過後に分 子状酸素(O<sub>2</sub>(chem))となり、少数キャリア (*k*mcr) を捕獲すると不対電子対が形成され、O<sub>2</sub>(chem) は直ちに解離されO原子が生成される。O原子 は活性が高いため、Si原子と直ちに結合したり、 Si-Siボンド間に挿入されたりし、SiO2膜が形成 される。一方、少数キャリアが捕獲できずに不 対電子対を形成できない場合、空孔に吸着した O2(chem)は空孔のバックボンドに侵入し、P60 とPb1を生成する。ここに再び吸着したO2(phys) は、バックボンドの酸化によっては長い寿命を 持つ<sup>6)</sup>。これにより少数キャリアの捕獲が可能 となり、O原子に解離して酸化が進行する。こ のPb0とPb1を経由した酸化反応をLoop B、経由 しない酸化反応がLoop Aである。このような二 つの反応パスを取り込んだ酸化膜厚の時間変 化の式が式(1)で表される。

このLoop A/Bモデルにおいて酸化現象が Loop AとLoop Bのどちらの反応経路を進むか は、空孔が少数キャリアを捕獲できる確率yA に依存する。この確率yA はSi基盤内で熱励起 される少数キャリアの数によって定まり、Si酸 化時の温度が高いほどLoop Aによる酸化が進 行する。これは、Fig. 1の結果と一致する。一方 で、2つの指数関数で表現されるXoの時間変化 だが、どちらの関数がLoop Aに対応するのかを



Fig.3. Time evolution of O atom chemical state during oxidation at (a)300°C, (b)550°C.

明らかにする必要がある。これを明らかにする ため、O原子の吸着配向性について調べた。

Si に結合した O 原子は、結合状態に依存し て大きな化学シフトを持つ。そのため、O1s 光 電子スペクトルのカーブフィッティング解析 <sup>7)</sup>から O 原子の結合配向状態ごとの時間変化を 求めた。Si-O 結合の配向状態は、ins(Si-Si 結 合間に挿入された O 原子)、tri(ins の状態の O 原子に別の Si 原子が近づき、3 配位に近い 状態となった O 原子)、ad(未結合手を持つ Si 原子と結合し Si-O となっている O 原子)、Paul

(解離しておらず  $O_2$ 分子のまま Si 原子と結合 している O 原子)の4 種類を仮定した<sup>4)</sup>。Fig.3 より 300°Cでは、*ins* が酸化開始から 500 秒ま で急激に増加し、それ以降緩やかに増加したの ちに値が飽和した。*tri* は酸化開始から 500 秒 まではほとんど増加せず、500 秒から増加する。 *ad* は酸化開始時から増加した。一方、550°Cで は*ins* と*tri* が 200 秒から 1000 秒まで急激に増 加し、それ以降緩やかに増加し後に値が飽和し た。*ad* は 200 秒から 1000 秒にかけて値が増加 したのち、飽和傾向を示した。

**Fig.1(b)**では酸化反応の割合の多くが Loop A で進行した。これに対し Fig.3(b)の酸化初期か ら *tri* と *ins* が同じ程度の割合で進行した。こ の結果から、酸化時の温度によって Loop A に



Fig.4. Correlation between O 1s intensity and oxide thickness in Loop A and B at 300°C.

おける酸素吸着配向が変化すると考えられる。 また、Fig.1(a)(b)では、温度が高いと総酸化膜厚 量及び Loop A による酸化膜厚量が増加した。 これに対し、Fig. 3 では温度が上がると ins の 値が減少した。この結果も温度による酸素吸着 配向の変化を示している。

酸素結合状態各成分と酸化膜厚の相関を Fig. 4 に示す。Fig.4(a)(b)から 300°Cにおいて、Loop A では ins - ins ペアが生成され Loop B では tri - ad ペアが生成されることがわかる。また、 Fig.4(b)で Loop B による膜厚が 0.04 nm にな るまでは tri と相関を持たないことから、Loop B の初期には ins-ad もしくは ad-ad の酸素吸着 状態を持っていたと考えられる。Fig.4(a)にお いて Loop A により成長した膜厚が 0.22 nm に なるとそれまで一定であった ins との相関がず れる。同時に tri との相関が見られることから、 Loop A にて ins-ins から ins-tri へと酸素吸着配 向が変化したと考えられる。これは Fig.2 に示 した Loop A/B モデルのそれぞれの反応経路に おける酸化吸着配向と一致する。

300℃における各酸素結合状態の相関を Fig. 5 に示す。Fig.5(a)では、*ins* と *tri* に相関がない



Fig.5 Correlation between O atom bonding state during oxidation. (a) ins vs tri, (b) ins vs ad, and (c) tri vs ad, respectively.

とわかる。Fig.5(b)では、酸化進行途中から tri と ad に相関が現れた。これは Loop B が tri と ad によって進行することを示す。また、 Fig.5(c)では、ins と ad に一部相関があった。こ れは酸化初期の Loop A で ins - ad が形成され ていることを示す。また、Fig.5(b)(c)に着目する と ad と tri、ins との相関が途中で変化してい る。これは、ad が Loop A、Loop B どちらの反 応経路においても生成されることを示し、 Loop A が飽和した後は Loop B のみで tri-ad の 結合が生じていると考えられる。

## 4. まとめ

Si初期酸化過程を調べるためにSiの表面お よび界面をリアルタイムXPSにて測定した。 300℃と550℃においてLoop A/Bモデルにより 酸化膜厚をフィッティングできた。温度上昇に より一段階酸化のLoop A が促進され、二段階 酸化のLoop Bが抑制されることが分かった。 その原因は熱励起により少数キャリアの正孔 が増加し、Loop AからLoop Bへの分岐が抑制 されたからである。酸素吸着配向がLoop Aと Loop Bで異なり、温度依存することが分かっ た。O1s光電子スペクトルから見積もった酸素 結合状態も温度に依存しており、Loop AとBの 分岐が酸素結合状態による可能性が示唆され た。

## 参考文献

 末光眞希、「シリコン表面熱酸化初期過程の 反応速度論」、表面科学 23,95(2002).

2) S. Ogawa, A. Yoshigoe, J. Tang, Y. Sekihata, Y. Takakuwa, "Roles of strain and carrier in silicon oxidation", Jpn. J. Appl. Phys. 59, SM0801 (2020). 3) 古西浩志、津田泰孝、吉越章隆、高桑雄二、 小川修一、「Si表面酸化における酸化誘起点欠

福発生の役割の研究」、日本大学生産工学部第 56回学術講演会講演概要, 4-18 (2023).

4) 小川修一、「熱酸化プロセスによる極薄シリ コン酸化膜形成機構の研究」博士学位論文(東 北大学、(2007).

5) Y. Tsuda, A. Yoshigoe, S. Ogawa, T. Sakamoto, Y. Yamamoto, Y. Yamamoto, Y. Takakuwa, "Roles of excess minority carrier recombination and chemisorbed  $O_2$  species at SiO<sub>2</sub>/Si interfaces in Si dry oxidation: Comparison between p-Si(001) and n-Si(001) surfaces" J. Chem. Phys. **157**, 234705 (2022).

6) F. Matsui, H. W. Yeom, K. Amemiya. K. Tono, T. Ohta, "Reinterpretation of the molecular  $O_2$  chemisorbate in the initial oxidation of the Si(111) 7×7 surface" Phys. Rev. Lett. **85**, 630 (2000).

7) Y. Tsuda, A. Yoshigoe, S. Ogawa, T. Sakamoto, Y. Takakuwa, "Observation of Chemisorbed O<sub>2</sub> Molecule at SiO2/Si(001) Interface During Si Dry Oxidation", e-J. Surf. Sci. Nanotechnol. **21**, pp. 30-39 (2022).